



面向世界科技前沿, 面向国家重大需求, 面向国民经济主战场, 率先实现科学技术跨越发展, 率先建成国家创新人才高地, 率先建成国家高水平科技智库, 率先建设国际一流科研机构。 —— 中国科学院办院方针



首页 组织机构 科学研究 人才教育 学部与院士 资源条件 科学普及 党建与创新文化 信息公开 专题

搜索

首页 > 科研进展

### 深圳先进院两篇学术论文被领域顶级会议ECTC录用并邀请作口头报告

文章来源: 深圳先进技术研究院 发布时间: 2017-06-13 【字号: 小 中 大】

我要分享

近日, 中国科学院深圳先进技术研究院先进材料研究中心汪正平和孙蓉领导的广东省先进电子封装材料创新科研团队两篇论文被国际顶级会议IEEE The Electronic Components and Technology Conference (ECTC, 2017, Orlando)接收。先进材料中心曾小亮和胡友根(代表张国平)受邀在大会上分别作口头报告。

曾小亮作题为A Novel Organic Substrate with Enhanced Thermal Conductivity 口头报告, 相关研究针对电子器件的小型化、微型化以及多功能化带来的散热困难的问题, 依据材料结构与性能之间的关系, 制备了一款新型导热有机基板, 为解决电子器件散热问题提供了一种行之有效的材料和方法。胡友根作题为Thermally Reversible and Crosslinked Polyurethane based on Diels-Alder Chemistry for Ultrathin Wafer Temporary Bonding at Low-temperature 的报告, 相关研究通过结构设计, 合成了一种新型可自修复的材料, 并将其应用至临时键和胶领域, 有望为芯片减薄提供一种新型的解决方案。两篇论文引起电子封装产业界和学术界的广泛关注, 受到一致好评。

ECTC会议是国际电气电子工程师协会电子元件封装和生产技术学会(IEEE-CPMT)顶级会议, 论文拒稿率高, 高达80%, 引领着当前电子器件发展方向, 众多电子器件相关的新技术、新方法和新思路都最先在此会议上报道。Intel、微软、IBM、美国德州仪器公司、日本松下电工、日立化成、台湾台积电、日月光、韩国三星、华为、中兴通讯等知名企业前往参会。此次会议中国大陆共被会议录用27篇论文(包括口头报告和墙报, 全球排名第四), 先进材料中心被接收的两篇口头报告论文是中国大陆地区仅有的两篇有关电子封装材料的论文。

(责任编辑: 叶瑞优)

### 热点新闻

#### 2018年诺贝尔生理学或医学奖、...

- “时代楷模”天眼巨匠南仁东事迹展暨塑...
- 中科院A类先导专项“泛第三极环境变化与...
- 中国科大建校60周年纪念大会举行
- 中科院召开党建工作推进会
- 中科院党组学习贯彻习近平总书记在全国...

### 视频推荐



【新闻联播】“率先行动”计划 领跑科技体制改革



【新闻直播间】物种演化新发现 软舌螺与腕足动物有亲缘关系

### 专题推荐



© 1996 - 2018 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号 联系我们 地址: 北京市三里河路52号 邮编: 100864